中信证券股份有限公司

关于杭州士兰微电子股份有限公司

变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对士兰微变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,000,000 股，每股发行价格为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 496,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元。本次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 14 日。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕603 号）。

截至 2026 年 10 月 31 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额（含利息）
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	160,000.00	-

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额（含利息）
SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	75,090.34
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	104,758.03
补充流动资金	165,000.00	146,306.11	146,306.11
合计	**1,005,000.00**	**491,306.11**	**326,154.48**

（二）变更部分募集资金投资项目情况

为加快核心业务的战略布局，加强核心资产的控制能力，优化资源配置，提高募集资金使用效率及效益，结合市场环境的变化及实际发展需求，经审慎研究和分析论证，公司拟对 2023 年向特定对象发行股票的募投项目之一“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”变更用途，将该项目全部募集资金 160,000.00 万元用于收购厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体”）所持有的公司之参股公司厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）20.344%股权并通过对士兰集科增资的方式用于其“新增年产 20.4 万片 IGBT 功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目”建设。本次变更前后募投项目及拟投入募集资金情况如下：

（1）募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

发行名称	2023 年向特定对象发行股票
募集资金总额	496,000.00
募集资金净额	491,306.11
募集资金到账时间	2023 年 11 月 14 日
涉及变更投向的总金额	160,000.00
涉及变更投向的总金额占比	32.57%
改变募集资金用途类型	√改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____

（2）变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入募集资金金额	是否已变更募投项目，含部分变更（如有）	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2023年向特定对象发行股票	年产36万片12英寸芯片生产线项目	杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）	士兰集昕现有厂房内	390,000.00	160,000.00	不适用	0 [注 1]	否	2023年向特定对象发行股票	收购士兰集科 20.344%股权	公司	不适用	不超过121,500.00 [注 2]	110,000.00	是
										新增年产20.4万片IGBT功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目	士兰集科	士兰集科现有厂房内	247,459.00	50,000.00	

注 1：截至目前，“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”已投入自有资金 6.70 亿元，尚未使用募集资金投入。

注 2：该部分股权预计于 2027 年 1 月完成交割，股权转让价格不超过 12.15 亿元，具体交易金额以股权实际交割日为依据计算。详见本核查意见三（一）5 之说明。

本次交易不属于重大资产重组事项。

公司董事陈向东、范伟宏由公司提名担任士兰集科董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，士兰集科为公司的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）除持有公司股份外，同时亦是本次交易标的士兰集科的重要股东（持有其10.566%股权）。公司董事李伟系大基金二期提名并在其任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，李伟基于董事身份的独立商业判断可能受到影响。

鉴于以上，为充分保障董事会决策的独立性与公正性，避免因或有利害关系对审议结果产生影响，基于谨慎性原则，陈向东、范伟宏、李伟在审议该议案时作为关联董事须回避表决。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”计划总投资 39 亿元，拟投入募集资金 16 亿元。该项目的实施主体为公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司，募集资金拟通过公司向士兰集昕增资的方式投入。该项目原计划建设形成一条年产 36 万片 12 英寸功率芯片生产线，用于生产 FS-IGBT、T-DPMOSFET、SGT-MOSFET 功率芯片产品。该项目原计划达到预定可使用状态日期为 2026 年 12 月。

截至目前，该项目已累计投入自有资金约 6.70 亿元，已建成 12 英寸功率芯片产能 1.1 万片/月。该项目尚未使用募集资金投入。

（二）变更的具体原因

原募投项目“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”计划总投资 39 亿元，原拟投入募集资金 30 亿元，因公司 2023 年向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目的金额，该项目的募集资金投入金额相应调整为 16 亿元，故项目尚有近 20 亿元的投资资金需要进一步落实。

2024 年以来，国内已有多条新建的 12 英寸功率器件芯片生产线通线及投产，且为满足下游汽车客户日益严苛的质量要求，新建产线大多配置了较高水平的自动化生产装备，使得功率半导体行业（包括车规级功率半导体行业）竞争进一步加剧，功率芯片价格持续下降。

士兰集昕现有厂房于 2017 年建成，系根据当时 8 英寸芯片生产线的要求所设计，未安装天车等自动化设备。为满足下游汽车客户日益严苛的质量要求，如若公司在士兰集昕现有厂房内继续实施该项目，则需要对现有厂房进行改造、拓展洁净厂房面积、增加天车等自动化系统等，以进一步提升生产线的可控性、可靠性和生产效率，这将会造成投资大幅增加而项目收益进一步降低。公司经谨慎评估后认为，如继续按原方案进行募集资金投入，则预期该项目经济性将变差。因此，公司拟根据市场需求对该项目的产品生产门类及相应的生产设备选型作进一步确定，目前方案还在论证中，故项目建设进度放缓，募集资金投入进度滞后。

综上，为进一步提升募集资金使用效率，从公司业务发展及维护股东利益出发，公司拟变更该募集资金用途。

（三）原募投项目的后续安排

结合市场环境的变化及实际业务发展需求，公司拟对原募投项目“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”的产品生产门类及相应的生产设备选型作进一步确定，目前方案还在论证中。

为提高募集资金使用效率、掌握先进生产资源、满足当下市场需求，公司拟变更该募投项目投向至“收购士兰集科 20.344%股权”及士兰集科“新增年产 20.4 万片 IGBT 功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目”。

三、新募投项目的具体内容

（一）“收购士兰集科 20.344%股权”基本情况

1、项目基本情况

根据公司与厦门半导体于 2021 年签订的《厦门士兰集科微电子有限公司增资协议》及《厦门士兰集科微电子有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“《增资协议》及《补充协议》”）的条款约定，公司拟与厦门半导体签署《股权转让协议》，收购厦门半导体持有的士兰集科 20.344%股权（对应士兰集科注册资本为 108,017.64 万元）。该部分股权预计于 2027 年 1 月完成交割，股权转让价格不超过 121,500.00 万元（具体交易金额以股权实际交割日为依据计算），其中拟使用募集资金 110,000.00 万元，剩余资金由公司自有资金支付。本次收购完成后，公司将合计持有士兰集科 47.791%的股权，公司将成为士兰集科第一大股东，并且士兰集科的法定代表人（执行公司事务的董事）将更换为由公司提名的董事担任，士兰集科将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围内。

本次交易的交易要素如下：

交易事项	√购买 □置换 □其他，具体为：
交易标的类型	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称及股权比例	厦门士兰集科微电子有限公司 20.344%股权
交易对方名称	厦门半导体投资集团有限公司
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	√是 □否
交易价格	不超过 121,500.00 万元，具体交易金额以股权实际交割日为依据计算
定价方法	根据双方前期签署的《增资协议》及《补充协议》中关于“受让与收购”条款约定的受让价格计算方式进行计算定价，详见本核查意见三（一）5 之说明
交易方式	向交易对方支付现金
资金来源	√自有资金 √募集资金 □银行贷款 □其他：____
支付安排	全额一次付清，约定付款时点：预计于 2027 年 1 月交割，具体以《股权转让协议》为准
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

2、交易对方情况介绍

公司名称	厦门半导体投资集团有限公司
统一社会信用代码	91350200MA2XUDEM91
法定代表人	吴文
成立时间	2016 年 12 月 9 日
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景中路 43 号 201 单元
注册资本	685,968 万元
公司类型	有限责任公司（国有控股）
主营业务	以自有资金从事投资活动等
主要股东	厦门海沧发展集团有限公司持有 63.89% 厦门海沧投资集团有限公司持有 36.11% （其实际控制人为厦门市海沧区人民政府）

3、交易标的暨关联人情况介绍

（1）交易标的基本情况

本次交易标的类别为股权资产，具体为厦门半导体所持有的士兰集科 20.344%股权（对应士兰集科注册资本为 108,017.64 万元）。

（2）交易标的权属情况

截至本核查意见出具日，本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（3）交易标的具体信息

（3.1）基本情况

公司名称	厦门士兰集科微电子有限公司
统一社会信用代码	91350200MA31GA8Q1C
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
法定代表人	吴文

公司名称	厦门士兰集科微电子有限公司
成立时间	2018 年 2 月 1 日
注册地址	厦门市海沧区兰英路 89 号
注册资本	5,309,503,753 元
公司类型	其他有限责任公司
主营业务	芯片制造
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
关联关系	公司董事陈向东、范伟宏由公司提名担任士兰集科董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，士兰集科为公司的关联法人
关联人股权结构	
其他情况说明	士兰集科未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。过去 12 个月内，公司与士兰集科之间的关联交易主要为日常关联交易

（3.2）主营业务情况

士兰集科主营业务为 12 英寸集成电路芯片的生产与销售，主要产品为 12 英寸特色工艺高压集成电路、功率器件芯片等。最近三年，士兰集科 12 英寸芯片产能逐步爬坡，已由月产 4.5 万片增加至 7 万片以上。士兰集科专注于 12 英寸晶圆制造业务，其主要客户为士兰微，其产品在经过士兰微及其子公司的封装和测试等后道工序后形成集成电路、分立器件、模组等成品，并进入下游终端应用领域。

（3.3）主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	厦门士兰集科微电子有限公司
标的资产类型	股权资产
本次交易股权比例（%）	20.344

是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2026 年 10 月 31 日/2026 年 1-10 月（经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
资产总额	1,090,037.51	1,046,704.10
负债总额	675,862.35	646,131.38
净资产	414,175.16	400,572.72
营业收入	320,612.35	318,746.60
净利润	13,602.44	-5,738.32

最近 12 个月内，士兰集科未进行资产评估、增资、减资或改制。

4、交易标的收购必要性

根据公司与厦门半导体于 2021 年签订的《增资协议》及《补充协议》的条款约定，士兰集科产线正式投产产出 7 年内或士兰集科在产线正式投产产出 7 年内达到盈亏平衡后的 1 年内，公司可以受让厦门半导体持有的士兰集科股权以满足最终公司所持士兰集科的股权比例不低于 51%的要求。（注：上述针对股权比例的约定是基于 2021 年签订《增资协议》当时所对应的士兰集科注册资本。士兰集科在 2022 年 4 月、2024 年 12 月又进行了两次增资，因此本次收购 20.344%股权后，公司持有士兰集科的股权比例达到当时注册资本所约定的 51%的相对比例要求。从士兰集科当前注册资本来看，公司虽未达到 51%的绝对股权比例，但公司成为士兰集科第一大股东，并根据上述《增资协议》相关约定取得对士兰集科的控制权。）

士兰集科自成立以来，通过债权和股权融资的方式使得总资产逐年增长，净资产也不断提升。正式投产以来，士兰集科通过不断的调整产品结构和产能爬坡，保持了营业收入的持续增长，营业利润由亏转盈，经营性现金流得到持续改善，研发投入持续保持较高水平。2026 年 1-10 月，士兰集科实现营业收入 32.06 亿元，实现净利润 1.36 亿元，全年亦有望实现盈利。目前，士兰集科 12 英寸芯片月产出已达到 7 万片以上，产能利用率达到 95%以上。随着人工智能、电动汽车、新能源（包括风光储充）、机器人等下游产业的快速发展，市场对优

质半导体芯片的需求将进一步增强。预计未来三年，随着士兰集科产能进一步扩大，营业收入仍将保持增长态势，盈利水平将得到持续改善。

综上，根据上述《增资协议》及《补充协议》的约定，并结合士兰集科的经营情况，公司判断目前已是收购该项资产合适的时机。本次收购具有必要性与可行性，因此公司审慎决定启动本次收购。

5、交易标的定价情况

根据上述《增资协议》及《补充协议》中关于受让与收购条款的约定，按照士兰集科在 2021 年协议签署时的注册资本 300,049 万元测算，公司从彼时持有的士兰集科 15%股权回购到 51%股权需要收购士兰集科彼时注册资本 300,049 万元的 36%，即本次标的股权为士兰集科现有注册资本 530,950.3753 万元的 20.344%的股权，对应注册资本为 108,017.64 万元。

受让价格按照该等出让股权所对应的投资本金与资金占用费之和（资金占用费=投资本金×投资期限×利率），即标的股权受让价格测算公式为：受让价格=X×（1+Y×N），其中 X 为本金 108,017.64 万元，Y 为年化资金使用成本 1.5%，N 为各期本金投资年数。

该部分股权预计于 2027 年 1 月完成交割，股权转让价格不超过 121,500.00 万元（具体交易金额以股权实际交割日为依据计算）。

本次股权收购交易价格的确定，是交易双方依法严格履行合同的行为，不涉及利益输送，不存在有失公允或损害公司及股东利益的情形。

6、收购完成前后士兰集科股权结构情况

本次士兰集科 20.344%股权收购完成前后，士兰集科的股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	本次收购前			本次收购后		
	认缴注册资本	实缴注册资本	认缴持股比例	认缴注册资本	实缴注册资本	认缴持股比例
士兰微	145,731.9891	99,433.5494	27.447%	253,749.6291	207,451.1894	47.791%
厦门半导体	329,119.1536	329,119.1536	61.987%	221,101.5136	221,101.5136	41.643%
大基金二期	56,099.2326	56,099.2326	10.566%	56,099.2326	56,099.2326	10.566%

股东名称	本次收购前			本次收购后		
	认缴注册资本	实缴注册资本	认缴持股比例	认缴注册资本	实缴注册资本	认缴持股比例
合计	**530,950.3753**	**484,651.9356**	**100.00%**	**530,950.3753**	**484,651.9356**	**100.00%**

注：截至目前，士兰微尚余 50,000.00 万元增资款（对应认缴注册资本 46,298.4397 万元）未支付。士兰微拟使用本次变更募集资金的 50,000.00 万元对其完成实缴出资。

7、《股权转让协议》的主要内容

本事项尚未经公司股东会审议，交易双方尚未签署《股权转让协议》。公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权公司法定代表人签署与本事项相关的协议等文件并办理相关手续。

（二）“新增年产 20.4 万片 IGBT 功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目”基本情况

根据公司与厦门半导体于 2024 年 9 月签署的《增资协议》，公司与厦门半导体分别出资 80,000.00 万元，认缴士兰集科注册资本 74,077.5036 万元。截至目前，公司尚余 50,000.00 万元增资款（对应认缴注册资本 46,298.4397 万元）未支付，公司拟使用本次变更募集资金的 50,000.00 万元完成该增资款的支付，并最终用于士兰集科“新增年产 20.4 万片 IGBT 功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目”建设。本次实缴出资完成后，士兰集科的股权结构不发生变化。

1、项目基本情况

“新增年产 20.4 万片 IGBT 功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目”计划在士兰集科现有芯片生产线及配套设施的基础上，通过购置和定制芯片生产设备提升 IGBT 功率器件芯片和模拟电路芯片的产能。项目实施地点为士兰集科现有厂房内。项目建设完成后，可以实现新增年产 20.4 万片 IGBT 功率器件芯片和模拟电路芯片的生产能力。

2、项目投资概算

该项目总投资 247,459 万元，包括：建设投资 237,459 万元，铺底流动资金 10,000 万元，其中，建设投资主要用于购置和定制设备。本次拟使用募集资金 50,000.00 万元，其余资金由公司自筹。公司使用募集资金投入内容全部为固定

资产投资，符合资本化要求。截至 2026 年 10 月 31 日，该项目已投入自有资金 177,464 万元。

3、项目建设周期及效益

项目建设周期为 5 年（2023 年 1 月-2027 年 12 月），税后内部收益率为 17.6%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.9 年。

4、环评及备案情况

士兰集科“新增年产 20.4 万片 IGBT 功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目”已取得厦海科工商投备〔2024〕132 号投资备案，已取得厦环审〔2023〕14 号环评批复。

5、项目建设最新情况

2026 年 1-10 月，该项目累计产出已达到 13.74 万片。2026 年 1-10 月，该项目实现销售收入 77,738.97 万元，销售毛利 21,515.19 万元，利润总额 10,076.58 万元。

（三）新募投项目必要性和可行性分析

公司本次将 2023 年向特定对象发行股票募投项目之一“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”变更用途，用于收购厦门半导体所持有的公司之参股公司士兰集科 20.344%股权并通过对士兰集科增资方式用于其“新增年产 20.4 万片 IGBT 功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目”建设，系基于宏观经济形势、市场环境、行业竞争格局，结合原募投项目的客观情况、公司实际经营情况和业务布局等因素作出的决策，其必要性和可行性分析如下：

1、有利于控制核心资产，保障上市公司利益

士兰集科自 2018 年成立后便投入 12 英寸芯片产品的研发和产能建设，2021 年开始规模量产，目前已形成月产 7 万片的生产能力。当前，士兰集科正在加快推进三期建设。三期建设及相关技改项目完成后，士兰集科的生产能力预计将提高到 8.5 万片/月。

士兰集科自投产以来（2021 年至今）累计向公司提供 12 英寸芯片约 299.51 万片。公司将上述 12 英寸芯片进一步加工成各种类型的产品，如智能功率模块（IPM）、汽车级和工业级大功率模块（PIM）、集成电路产品、功率器件产品（包括单管和芯片）等，销售给下游大型白电、通讯、汽车、工业、新能源、安防、手机、笔电等生产厂商，有效带动了公司营收的持续增长。

当前，士兰集科产能利用率已处于满载水平，经营确定性增加，利润实现扭亏为盈，投资风险大幅降低。随着“新增年产 20.4 万片 IGBT 功率器件芯片及模拟电路芯片扩产项目”的进一步实施，12 英寸芯片生产线产能将进一步释放，盈利能力将进一步增强。公司现阶段启动本次交易，有利于公司进一步增强对核心资产的控制，增强公司对主流晶圆制造线的控制力，保障上市公司利益。

2、有利于大幅减少日常关联交易，增强上市公司经营能力

士兰集科具备优秀的 12 英寸芯片生产线及生产能力，是公司主要的 12 英寸芯片供应商，目前双方之间存在较大的日常关联交易，2025 年及 2026 年 1-10 月公司向士兰集科采购商品及接受劳务合计金额分别为 31.65 亿元和 31.99 亿元。本次收购完成后，士兰集科将成为公司的控股子公司，有利于大幅减少日常关联交易规模、增强公司独立运营能力及抗风险能力，也有利于大幅增厚公司资产。

公司目前拥有 5 英寸、6 英寸、8 英寸硅基芯片生产线各 1 条，拥有 6 英寸 SiC 功率器件芯片生产线和 4 英寸化合物芯片生产线，拥有功率模块和功率器件封装生产线。本次收购完成后，公司将以控股方式纳入 1 条先进的 12 英寸集成电路和功率半导体芯片生产线，进一步充实公司在 12 英寸工艺平台的产能布局，更有利于公司利用有多条不同尺寸硅芯片产线和化合物产线的特点拓展工艺技术与产品平台，持续提升综合能力，发挥 IDM 模式的优势，聚焦高端客户和高门槛市场，不断提升上市公司价值。

3、有利于上市公司优化资源配置，加快先进产线建设

本次募投项目变更投向为士兰集科 12 英寸芯片生产线的收购及其项目建设，与原募投项目同属 12 英寸芯片生产线项目，具备一定相关性，是公司 12 英寸芯片产能布局的合理优化与延伸。同时，士兰集科具备丰富的 12 英寸芯片生产线的建设和研发能力，为拟变更项目顺利实施提供了良好的技术支撑和借鉴。本次变更完成后，公司将统筹杭州、厦门两地 12 英寸产能资源，在既有产能基础上进一步聚焦先进工艺与规模化建设，优化公司资源配置，加快 12 英寸先进产线建设进度，提升整体运营效率与生产能力。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

当前，随着人工智能、电动汽车、新能源（包括风光储充）、机器人等新兴产业的飞速发展，相关应用领域需求持续扩张，模拟电路和功率半导体产品具有广阔的市场前景。本次收购及增资完成后，有利于公司整合 12 英寸特色工艺产线资源，大幅扩充功率半导体、模拟集成电路等核心产品的规模化量产能力，强化自身 IDM 模式综合优势，推动公司主营业务持续成长；同时有利于深化产业链上下游协同效应，降低生产与研发成本，加速高端芯片国产替代进程，提升公司在半导体行业的核心竞争力与长期盈利水平，进一步提升股东回报。

（二）风险提示

本次交易完成后，士兰集科将成为公司合并报表范围内的控股子公司。士兰集科未来在经营过程中可能面临宏观经济波动、行业景气度变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场竞争风险、经营管理风险等，其未来的经营情况存在一定的不确定性，具体如下：

1、市场竞争风险

未来，随着上述新兴产业的不断扩大，行业景气度提升可能吸引更多竞争者进入，市场竞争将更加激烈，叠加部分原材料阶段性上涨等因素，士兰集科可能将面临毛利率阶段性下降的风险。本次收购完成后，公司将持续推进 12 英寸产线的产品结构优化，加强供应链管理和制造工艺改进，提高生产效率，降低生产

成本，多措并举提升产品综合毛利率，增强士兰集科持续盈利能力。目前，公司产品已大量进入汽车、新能源、工业、大型白电、算力和通讯等高门槛市场和头部客户。未来几年，公司将继续发挥设计制造一体化的协同优势，进一步扩充研发人员，加快高端集成电路产品的系列化开发，持续提升产品附加值。

2、经营管理风险

当前，相关领域客户对公司生产管理及产品品质的要求不断提高。为持续保持竞争力，士兰集科需要在产品研发、制造工艺研发、设备更新维护、人才梯队培养等环节持续投入，其生产经营管理将面临新的挑战。

针对经营管理风险，公司将支持和配合士兰集科，通过引进专业人才、加快技术创新、优化运营流程，持续提升经营管理水平；同时不断提高生产工艺技术水平，加强成本控制，保障产品质量。

五、本次变更部分募投项目暨关联交易事项对上市公司的影响

（一）本次变更部分募投项目暨关联交易事项是公司根据市场环境变化及实际业务发展需求做出的合理调整，新募投项目与公司主营业务紧密相关，符合公司长期发展战略规划，有利于提高募集资金使用效率和效益，有利于增强公司竞争能力和创新能力，有利于推动公司主营业务可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

本次变更部分募投项目所涉及的收购关联法人士兰集科部分股权事项，系交易双方根据前期签署的已生效协议的约定，依法行使合同权利，交易价格严格依据协议条款确定，交易具有必要性、合理性，符合公平、公正、诚信原则，不涉及利益输送，不存在有失公允的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次收购完成后，士兰集科将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围内，有利于显著增加公司资产规模，并大幅减少公司日常关联交易金额。本次交易对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。

（二）本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；本次交易完成后将大幅减少日常关联交易；本次交易不会产生同业竞争；本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

截至目前，士兰集科不存在对外担保、委托理财等情况。

六、本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 11 月 15 日召开的第九届董事会独立董事专门会议第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会战略与投资委员会议审议情况

公司于 2026 年 11 月 15 日召开的第九届董事会战略与投资委员会第三次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》并同意将该议案提交董事会审议，关联委员陈向东、范伟宏、李伟已回避表决。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第十三次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，关联董事陈向东、范伟宏、李伟已回避表决。《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》尚须提交股东会审议，在获得股东会审议通过的前提下，董事会同时提请股东会授权公司法定代表人签署与本事项相关的协议等文件并办理相关手续。

（四）股东会审议情况

本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（五）有关部门批准情况

本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项不需要经过有关部门批准。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，并将提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次变更募投项目符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州士兰微电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

姜　浩　　陈俊杰

中信证券股份有限公司

2026 年 11 月 20 日